

エレクトロニクス実装のレベルアップセミナー(1泊2日コース)

- 主 催: 合同会社フロンティア・アライアンス ものづくりリエゾンオフィス(MLO)
- 共 催: (社)溶接学会 マイクロ接合研究委員会
(社)日本溶接協会 マイクロソルダーリング教育委員会
大阪大学大学院工学研究科 生産科学コース
- 日 程: 2007年11月7日(水)~8日(木)
- 場 所: ホテル NCB(中之島センタービル)
大阪市北区中之島6丁目2-27 Tel. 06-6443-2255
<http://www.hotel-ncb.co.jp/>
- 参加費: 登録会社 31,500円(1日目交流会夕食代含む)
共催団体 52,500円(1日目交流会夕食代含む)
一 般 63,000円(1日目交流会夕食代含む)

11月7日(水) (1日目)

- 10:30~12:00 エレクトロニクス実装を科学する 講師: 藤本公三(大阪大学大学院工学研究科)
- 13:00~18:20 エレクトロニクス実装の金属材料学 講師: 廣瀬明夫(大阪大学大学院工学研究科)
(金属物理学、金属組織学、界面反応工学)
ソルダーリング実装部の界面反応
ワイヤボンディング部の界面反応
化合物組成は何によって決まるのか?
冷却速度と凝固組織の関係
相互拡散の原理と拡散速度
- 18:30~21:00 Night セッション (交流会)

11月8日(水) (2日目)

- 9:00~12:00 熱設計・構造設計 講師: 寺崎 健((株)日立製作所)
熱設計の基礎
熱の発生と伝わり方
実装構造の熱計算
その他
構造設計の基礎
応力とひずみの関係
強度評価
有限要素法の概略
はんだ接合部の疲労寿命評価
- 13:00~16:00 エレクトロニクス実装部の信頼性評価 講師: 藤本公三(大阪大学大学院工学研究科)

熱疲労信頼性
クリープ
振動
ウイスカ
イオンマイグレーション

※プログラムの内容は変更となる場合があります。

●申込み

セミナーに参加ご希望の方は、下記内容を明記して、
liaison@fa-mlo.com 宛にE-mailにてお申込み下さい。

1)氏名

2)会社名(部署)

3)連絡先住所、郵便番号

4)連絡先TEL

5)連絡先E-mail

6)参加費の支払い: ■ 銀行への振込(月 日) / ■ 現金書留

(振込口座、送り先は後日請求書にてご連絡いたします。10月31日までにお支払いが確認できるようにお願いいたします。)

7)参加区分(登録会社 31,500円、共催団体 52,500円、一般 63,000円)

8) 宿泊希望(有・無)(1泊 7,000円 朝食代・税サービス料込み)

●問合せ先: 合同会社フロンティア・アライアンス ものづくりリエゾンオフィス(MLO)

Eメール ; liaison@fa-mlo.com

ホームページ; <http://www.fa-mlo.com/>

MLO